

国家鼓励发展的内外资项目 确 认 书

NO: 000985

根据国务院国发[1997]37号文的规定，兹确认：由昆山经济技术开发区管理委员会于2017年3月以昆开基[2017]47号备案的华天科技（昆山）电子有限公司 Bumping 晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目，符合国家产业政策。请按规定到项目主管地直属海关办理进口设备免税手续。

项目统一编号：C13220172300985

项目产业政策审批条目：《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类第28类第19条（N2819）

项目单位：华天科技（昆山）电子有限公司

项目性质：国内投资鼓励项目

项目内容：采用 Bumping 技术，购置进口设备仪器 30 台（套），形成年产 3.5 万片 Bumping 技术封装晶圆的生产能力。

项目执行年限（起始年/终止年）：起 2017 年 4 月/止 2019 年 3 月

项目投资总额：4898 万元人民币

项目用汇额：709.58 万美元

（第一批进口设备用汇额 56.24 万美元）

（第二批进口设备用汇额 653.34 万美元）

抄送：南京海关

二零一八年四月四日



项目统一编号: C13220172300985

华天科技（昆山）电子有限公司
Bumping 晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化
项目进口设备和技术清单（第二批）

华天科技（昆山）电子有限公司
(印章)

(单位: 万美元)

序号	进口设备	技术规格	单价	台(套) 数	用汇额	拟进口国 别/地区	备注
1	推拉力测试机	DAGE 4000	37.5	5	187.5	荷兰	
2	编带机	DS 20000 T&R(纽约)或 Mi30(MIE)	38.5	9	346.5	马来西亚/ 德国	
3	编带检测机	Real inspection	11.8	1	11.8	台湾	
4	测试机	S50	7.8	10	78	日本	
5	撕膜机	DFM2800	25	1	25	日本	
6	四探针测厚仪	RG-3000	4.54	1	4.54	日本	
总计				27	653.34		

填表日期: 2018 年 3 月 23 日

联系人: 温馨

电话: 0512-50353709

江苏省发展和改革委员会审核意见
(盖章同意)